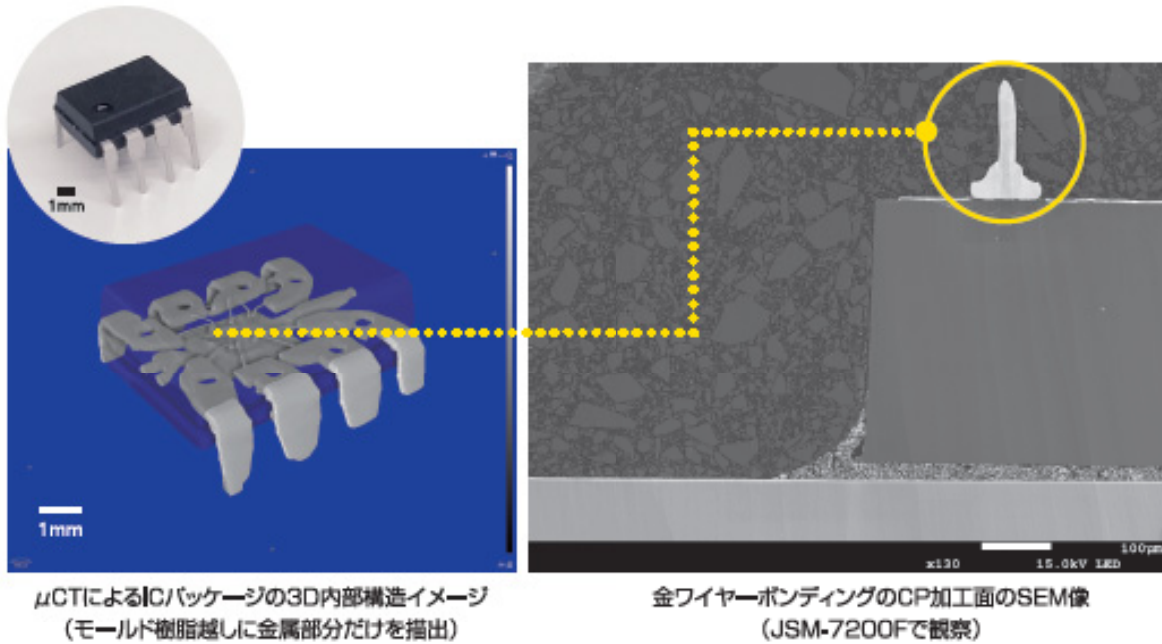


試料の精密断面加工における新提案

関連製品：X線CT微細構造解析システム(μCT)、断面試料作製装置(CP)

断面試料作製で頼りになる強力なアイテム登場！



μCTによるICパッケージの3D内部構造イメージ
(モールド樹脂越しに金属部分だけを描出)

金ワイヤーボンディングのCP加工面のSEM像
(JSM-7200Fで観察)

SEM観察用試料を断面加工する前にX線CT装置にて非破壊3Dイメージを取得することにより内部構造が把握でき、目的箇所を効率よく確実に断面作製することが可能になります。

特に不透明試料に対して有効で、過剰研磨等による観察対象の喪失リスクが抑えられますので、貴重な試料でも安心して断面加工することが可能です。

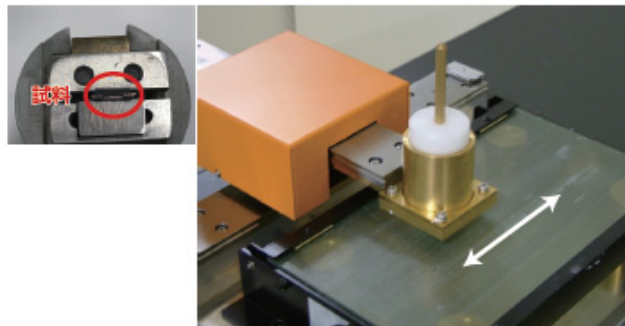
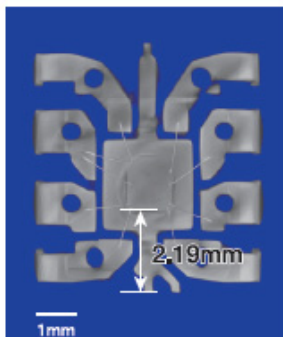


X線CT微細構造解析システム
μCT50

断面試料作製装置(CP)
IB-19530CP

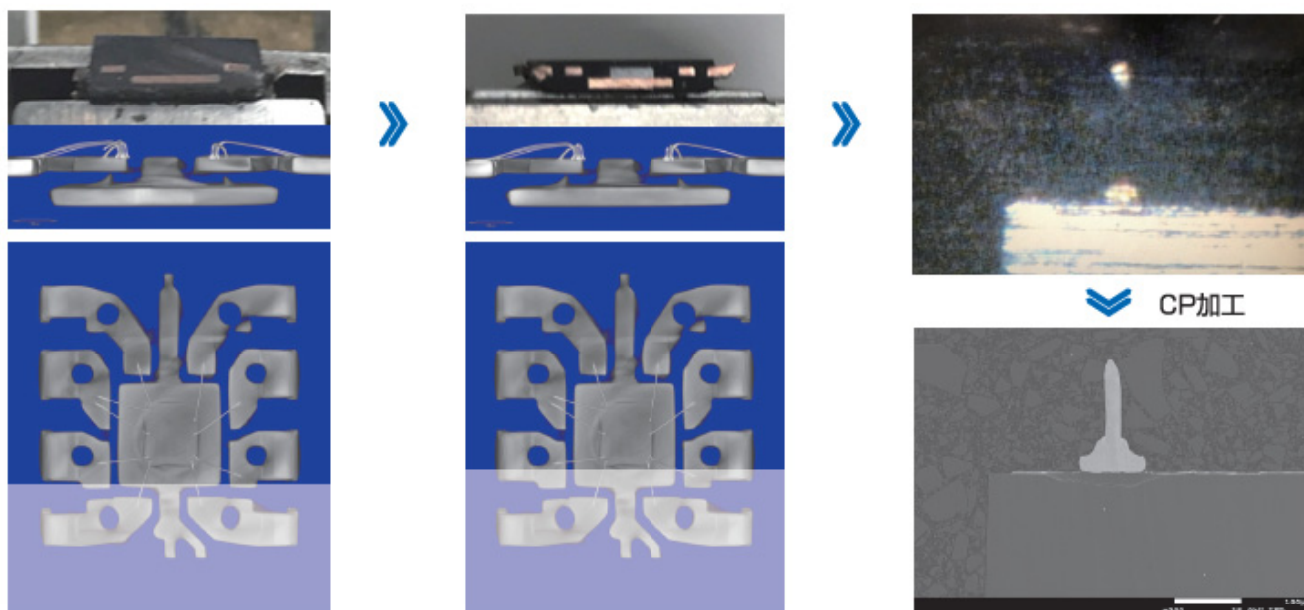
CP加工前の研磨作業

μCTによる内部構造イメージであらかじめ確認したボンディング位置を参考に精密平面研磨機（ハンディラップ）にて目標点近傍を狙って研磨していきます。



精密研磨進行状況とμCTによる断面確認用イメージ

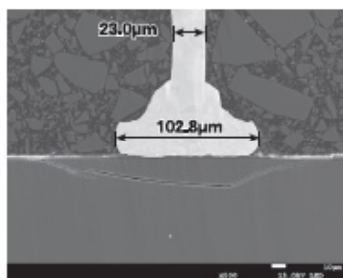
内部構造を事前に把握しておくことで、目的部位直前まで確実に研磨することが可能です。



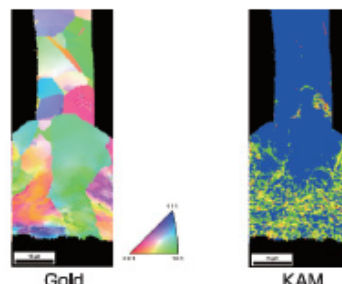
観察・測長・解析



μCTで非破壊断面構造確認・簡易測長



CP加工後にSEMで詳細観察・高精度測長
(JSM-7200F使用)



EBSD方位マップ像

Copyright © 2020 JEOL Ltd.

このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせ下さい。

